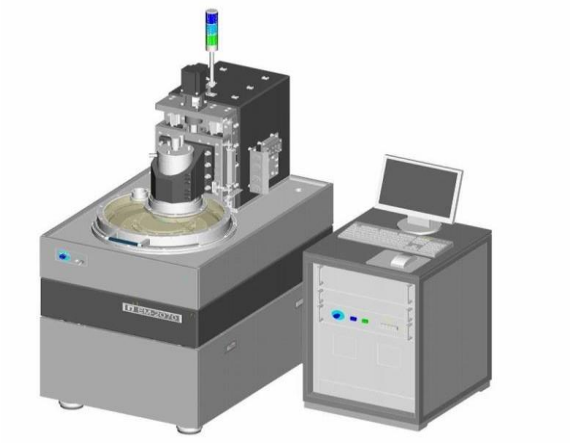
EM-2070 高精度晶圆研磨机

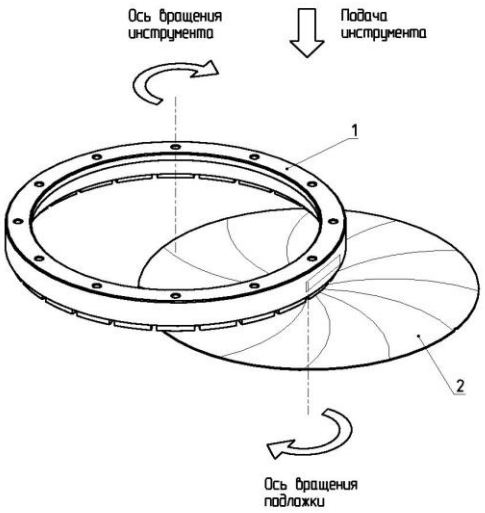


EM-2070 是一套高精度磨片系统，晶圆的另一面贴膜保护。

手动装、卸晶圆

使用特制的金刚石工具清洁干燥的表面研磨

晶圆研磨旋转示意图：



1 – 研磨工具;
2 – 晶圆.

功能参数：

晶圆直径, mm	100, 50, 200 (300 可选)
电动轴数量，个	1
电动轴额定功率, kW	4.5
主轴转速，rpm	1000-4500
工作台转速, r/min	300
同一晶圆厚度差， mkm	5 for d200
不同晶圆的厚度差, mkm	+/-5 for d200
直径 200 mm 晶圆磨片后可达到尺寸, mkm	240
不含装卸时间，研磨掉 100 微米的效率, wafers/h	30 for d200
表面粗糙度, Ra, mkm	0.08-0.2 (取决于所使用的工具)
外形尺寸, mm:	
- 长	1500
- 宽	1000
- 高	1750